

經濟部中小企業處 書函

機關地址：臺北市羅斯福路2段95號3樓
聯絡人/聯絡電話：游雅涵 (02)23680816#221
電子郵件：yhyou@moea.gov.tw
傳 真：(02)23673883

臺中市總工業會轉發

420

台中市豐原區東仁街138號

受文者：臺中市總工業會

發文日期：中華民國111年7月13日

發文字號：中企輔字第11100151830號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

臺中市總工業會收文章
第 671 號
111 年 7 月 19 日

主旨：函轉科技部「2022台灣創新技術博覽會－未來科技館」辦理之TIE Award徵件訊息(如附件)，請協助轉知並鼓勵企業踴躍報名參展，請查照。

說明：依據科技部111年7月7日科部產字第1110042639號函及本部工業局111年7月12日工知字第11100707520號函辦理。

正本：各縣市中小企業服務中心、各縣市工業會、各縣市商業會

副本：

經濟部中小企業處

中華民國八十二年一月一日

科技部 函

地址：106臺北市大安區和平東路二段106號
聯絡人：林冠儀
電話：02-2737-7232
傳真：02-2737-7619
電子信箱：kylin@most.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國111年7月7日
發文字號：科部產字第1110042639號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(附件1)

主旨：有關「2022 台灣創新技術博覽會- 未來科技館」辦理之 TIE Award徵件，自即日起受理，請查照並協助轉知所屬推廣報名。

說明：

一、旨揭展會將於111年10月13日(四)至10月15日(六)於台北世貿一館展出，為打造台灣成為全球科研重鎮，將以台灣最具知名度之半導體為主軸，鼓勵全球新創、法人及學研機構提出相關技術與應用，並來台於未來科技館實體展出，與我國大廠交流媒合、促進技術與人才落地。

二、徵件說明如下(詳附徵件DM)：

(一)報名資格：

- 1、全球科技新創、法人及學研機構，並請重點邀請中東歐國家如斯洛伐克、波蘭及波羅的海三國參與。
- 2、本獎項鼓勵全球團隊提出半導體於人工智慧(AI)與人工智慧物聯網(AIoT)、感測器、高效節能、通訊/衛星、智慧製造、自駕車、新能源等領域之研發與應用方案。
- 3、以「應用創新性Application innovation」、「價值創造性Value creation」及「在地連結性Local

111/07/08 一般公文總收



11100707520

111/07/08 經濟部總收



11100653490

integration」為評分標準，選出10隊獲獎團隊。

4、獲獎團隊須配合於實體展展出並與台灣企業鏈結，本部將於名單確定後協助來台事宜。

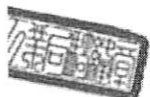
(二)報名方式：團隊須於台灣時間111年8月7日前至 T I E Award 徵件網站完成線上報名 (www.futuretech.org.tw)。

(三)獲選獎勵：

1、本獎項獎金逾10萬美金(新台幣300萬元)，第一名為3萬美元；第二名為2萬美元；第三名為1萬美元，及特別獎7名，分別可獲獎金7,000美元。

2、此外，獲獎者可享有TIE展會國內外的行銷資源，包括實體及線上展示空間、系列宣傳，及台灣科技新創基地(TTA)進駐空間、台灣半導體研究中心(TSRI)特定平台服務等資源。且獲獎團隊將能爭取與全球頂尖半導體企業合作之機會。

(四)本案聯絡窗口：Annett Wu, Taipei Computer Association, Tel : 886-2-2576-2013、E-mail: annett@mail.tca.org.tw



正本：中央研究院、國防部、教育部、經濟部、勞動部、行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環境保護署、國家發展委員會

副本：台北市電腦商業同業公會

部長吳政憲

